



**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Автоматическая установка монтажа кристаллов методом эвтектической пайки AD832U



Установка AD832U предназначена для производства дискретных компонентов в корпусах SOD323, SOD923, SOT113 и т.д. Гибкость конфигурации установки позволяет использовать ее в том числе для процессов флюсовой эвтектической пайки кристаллов, а также монтажа кристаллов на клей.

Установка AD832U может быть встроена в автоматическую линию с установкой разварки кристаллов.

Параметры	AD832U
Точность монтажа	$\pm 20,0$ мкм, $\pm 3,0^\circ$, 3σ
Производительность	До 22 000 кристаллов в час
Габариты кристаллов	От 0,15 x 0,15 до 2,54 x 2,54 мм (эвтектическая пайка); от 0,15 x 0,15 до 5,08 x 5,08 мм (флюсовая пайка, монтаж на клей)
Толщина кристаллов	От 50 мкм
Диаметр пластин	150 мм, 200 мм
Типы подложек	Платы, выводные рамки
Габариты подложек	Длина от 110 до 300 мм; ширина от 12 до 100 мм; толщина от 0,1–1,0 мм
Рабочая область	До 300 x 160 мм или 300 мм диаметр
Подогрев рабочего стола	Преднагрев до 400°C $\pm 10^\circ$ C; нагрев в зоне монтажа до 500°C $\pm 5^\circ$ C; постнагрев до 400°C $\pm 10^\circ$ C
Сила прижима	30–300 г
Электропитание	220 В; 50 Гц; 3,52 кВт; 16 А
Сжатый воздух	Не менее 6 бар, 350 л/мин (азот 780 л/мин)
Формир-газ (N ₂ +H ₂)	5 бар, 25–28 л/мин
Габариты, вес	1855 x 1263 x 2775 мм, 1050 кг

ООО «ЛионТех-С»
mail@liontech.ru



Звонок по России бесплатный:

8 800 555 6889

8 (812) 309-27-37

8 (495) 646-14-76

www.liontech.ru

*Технологическое оборудование и расходные материалы
для производства электроники*